

<<SMT基础与工艺>>

图书基本信息

书名：<<SMT基础与工艺>>

13位ISBN编号：9787111352303

10位ISBN编号：7111352300

出版时间：2011-9

出版时间：机械工业

作者：何丽梅 编

页数：242

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<SMT基础与工艺>>

内容概要

《smt基础与工艺》主要包括表面组装元器件、表面组装基板材料与smb设计、表面组装工艺材料、表面组装涂敷与贴装技术、表面组装焊接工艺、表面组装清洗工艺、表面组装检测工艺等内容。具有很高的实用参考价值，适用面较广，编写中强调了生产现场的技能性指导，特别是印刷、贴片、焊接、检测等smt关键工艺与关键设备使用维护方面的内容尤为突出。为便于理解与掌握，书中配有大量的插图及照片。

《smt基础与工艺》可作为高等职业院校或中等职业学校smt专业或电子制造工艺专业的教材；也可作为各类工科学校器件设计、电路设计等与smt相关的其他专业的辅助教材。

<<SMT基础与工艺>>

书籍目录

出版说明

前言

第1章 概论

1.1 smt的发展及其特点

1.2 smt及smi工艺技术的基本内容

1.3 习题

第2章 表面组装元器件

2.1 表面组装元器件的特点和种类

2.2 无源表面组装元件smc

2.3 表面组装器件smd

2.4 smt元器件的包装方式与使用要求

2.5 习题

第3章 表面组装基板材料与smb设计

3.1 smt印制电路板的特点与材料

3.2 smb设计的原则与方法

3.3 smb设计的具体要求

3.4 习题

第4章 表面组装工艺材料

4.1 贴片胶

4.2 焊锡膏

4.3 助焊剂

4.4 清洗剂

4.5 其他材料

4.6 习题

第5章 表面组装涂敷与贴装技术

第6章 表面组装焊接工艺

第7章 表面组装清洗工艺

第8章 表面组装检测工艺

第9章 smt生产线与产品质量管理

参考文献

<<SMT基础与工艺>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>